

INFORME DE BÚSQUEDA DE PATENTES				
N° de solicitud: NC2017/0007332				
CRITERIOS PARA LA BÚSQUEDA (Anexar pantallazo o reporte en PDF, junto con los boléanos utilizados*. Para el caso de secuencias, anexar alineamientos)				
Palabras clave utilizadas		Temperature, heat, flow, resistance, capacitor, wall, time, power, calculated,		
CLASIFICACIONES UTILIZADAS PARA LA BÚSQUEDA		CIP: G01N 25/18, G01K 17/20.		
		CPC :		
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (documentos patentes, literatura no patente, etc...)				
Informes/Base de datos	N° de solicitud/ Autor**	Fecha de Publicación/Presentación (DD/MM/AAAA)	Reiv. afectadas (Con indicación, si procede, de las partes relevantes o números de secuencias)	Categorías especiales de los documentos citados***
Patbase	AU2008264146	09/07/2009	-	A
	EP1020784	19/07/2000	-	A
	US4644138	17/02/1987	-	A
SIPI	08128174	31/04/2009	-	A
	11032480	20/05/2011	-	A
Google Patents	ISO ¹	01/08/2014	Reiv. 3 a 6 (Fl. 10, Pág. 4).	Y
	Luca Evangelisti; Claudia Guattari; Paola Gori; Roberto De Lieto Vollaro ²	05/08/2015	-	A
	US20100286843	11/11/2010	-	A
	US20100211222	19/08/2010	-	A
IEEE	Boris Vaisband; Ioannis Savidis; Eby G. Friedman ³	28/07/2014	-	A
	M. Adamek; J. Prasek; P. Melichar; I. Szendiuch; L. Jakubka ⁴	08/08/2005	-	A
	D. Agonafer; S. Furkay ⁵	06/08/2002	-	A
Orbit	US20090249726	08/10/2009	-	A
	WO2012037631	29/03/2012	-	A
	US2011099926	05/05/2011	-	A
	CN104990952	21/10/2015	-	A
EPOQUE	EP2317290	04/05/2011	-	A
	WO2012049417	19/04/2012	-	A
	EP1760441	07/09/2007	-	A
	WO2008023353	28/02/2008	-	A
EPO	WO2011117356	29/09/2011	Reiv. 1 a 7, 11 a 16 ((Pág. 13, Fl. 15, línea 27 a Pág. 14, Fl. 16, línea 14); (Pág. 15, Fl. 16, línea 9 a Pág. 16, Fl. 18, línea 14); (Pág. 24, Fl. 26, líneas 9 a 16); (Pág. 27, Fl. 27, líneas 23 a 29); (Pág. 24, Fl. 26, líneas 9 a 16); (Pág. 27, Fl. 27, líneas 23 a 29)).	X, Y
	US20130226503	29/08/2013	Reiv. 15 a 22 ((Pág. 6, Fl. 12, Párr. 0080); (Pág. 6, Fl. 12, Párr. 0092); invención (Pág. 8, Fl. 14, Párr. 0126); (Pág. 4, Fl. 10, Párr.0058); (Pág. 6, Fl. 12, Párr. 0080); (Pág. 1, Fl. 7, Párr. 0003); (Pág. 5, Fl. 11, Párr.	X, Y

			0066). (Pág. 5, Fl. 11, Párr. 0067); (Pág. 9, Fl. 15, Párr. 0127); (Pág. 9, Fl. 15, Párr. 0129 - 0137)).	
	FR2528172	09/12/1983	-	A

*** Categorías especiales de documentos citados:

“A” documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “P” documento publicado antes de la fecha de presentación internacional, pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“X” documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
---	--

**** Indicar entre paréntesis la Autoridad que realizó la búsqueda o el informe preliminar Ejs: EPO, JP, INAPI.

Literatura no patente	¹ ISO, E. 9869-1: 2014 (E). Thermal insulation-Building elements-In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance, Part, 1. ² Evangelisti, L., Guattari, C., Gori, P., & Vollaro, R. D. L. (2015). In situ thermal transmittance measurements for investigating differences between wall models and actual building performance. Sustainability, 7(8), 10388-10398. ³ Vaisband, B., Savidis, I., & Friedman, E. G. (2014, June). Thermal conduction path analysis in 3-d ics. In Circuits and Systems (ISCAS), 2014 IEEE International Symposium on (pp. 594-597). IEEE. ⁴ Adamek, M., Prasek, J., Melichar, P., Szendiuch, I., & Jakubka, L. Sensor for lowest flows measurement. In Electronics Technology: Meeting the Challenges of Electronics Technology Progress, 2005. 28th International Spring Seminar on (pp. 45-49). IEEE. ⁵ Agonafer, D., & Furkay, S. (1990, February). Numerical and experimental investigation of heat transfer phenomena over an electronic module. In Semiconductor Thermal and Temperature Measurement Symposium, 1990. SEMI-THERM VI, Proceedings., Sixth Annual IEEE (p. 103). IEEE.
Fecha del reporte de búsqueda:	11/07/2018